

技术参数

G5805

Date:05/17
Web:www.stick1mat.com



上海禧合应用材料有限公司

应用介绍

特点

一款单组分、高导热环氧胶，可低温固化；高 Tg 高可靠性；对玻璃、陶瓷、塑料及金属等材料具有良好的粘接力，尤其使用于 PCB 及元器件的粘接。

粘接材料

玻璃，金属，陶瓷等

典型应用

电子热敏感器件之间粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂胶粘剂	
颜色	灰色	
粘度(cps)	2997	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化	60mins@80°C	
有效期@ -20°C,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	棕色	
邵氏硬度	52D	ASTM D-2240
玻璃化温度	141°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
粘接强度	≥8MPa	AL+AL
导热率	>1.8 w/(m.k)	
降解温度	350°C	

可靠性	数值	测试方法
吸水率	<1%	ASTM D 570-98
工作温度范围	-55°C—150°C	

储存和使用方法

产品需低于-20°C环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

包装规格：

30ml 针筒；55ml 针筒；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。